

# 真空ソルダリングシステム

Model:SQ1 仕様

仕様	SQ1
チャンバ数	1チャンバ(加熱&冷却)
装置サイズ	約W1000 x D750 x H1300 約450kg
処理スペース	W300 x D300 x H100 (12inch対応)
加熱方式	IRヒーター 加熱温度 MAX.400℃
冷却方式	水冷プレート
真空ポンプ	耐食型ドライポンプ 真空到達度 20Pa以下
排気処理	ギ酸分解処理ユニット搭載

# Vacuum Reflow Soldering System

## Model : SQ1 Specification

Specification	SQ1
Number of chamber	1(Heating & Cooling)
Dimensions (mm)	W1000 x D750 x H1300 (450kg)
Process area (mm)	W300 x D300 x H100 (12inch)
Heating	IR heaters Temperature up to 400°C
Cooling	Water-cooled plate
Vacuum pump	Corrosion-proof type dry pump 20Pa or less
Exhaust treatment	Formic acid decomposition unit